



SMTA China South 华南高科技会议 Technology Conference

29th August 2017 (Tuesday) / 2017 年 8 月 29 日(星期二)

(CS17-VC1) Vendor Conference / 高科技设备研讨会

Conference Chairman/会议主席:

Maverick Luk 陆智能

Executive Committee Member of SMTA China / 中国 SMTA 执行委员会委员

Public Relations Manager of Electronic Technology Publishing Group / 电子技术出版集团公共关系经理

Venue/地点	Booth 1R88, Hall 1., Shenzhen Convention & Exhibition Center, Shenzhen, China 中国深圳会展中心 1 号馆 1R88 展位	
Time/时间	Topic/议题	Speaker/主讲人
10:30 – 10:55	PCB Rework Process and New Technology Report PCB 板返修技术趋势及工艺更新报告 (CS17-VC1.1)	Leo Zou 邹飞龙 VJ Electronix Inc. 美国 VJE 公司
11:00 – 11:25	The Latest Component Counting Trend --- X-Ray Component Counting and data Sharing With MES 最新的自动化元件数料趋势-- X 射线点料技术及生产管理信息共享 (CS17-VC1.2)	Jeremy Zhou 周铭 VJ Electronix Inc. 美国 VJE 公司
11:30 – 11:55	Effective Board Level Testing 高效的板阶测试 (CS17-VC1.3)	Tomi Savolainen Cencorp Automation 申科谱自动化
12:00 – 12:25	JBC Net Born for Industry 4.0 手工焊接工业 4.0 解决方案 (CS17-VC1.4)	Billy Shen 沈懿俊 JBC Soldering Tools (Shanghai) Trading Co., Ltd. 捷毕禧(上海)贸易有限公司
12:30 – 13:30	Lunch Break / 午餐	
13:30 – 13:55	Smart Odd-Form Insertion Solution 灵活的异型插件解决方案 (CS17-VC1.5)	Marko Tamminen Cencorp Automation 申科谱自动化
14:00 – 14:25	Smart #1 SMT Factory #1 SMT 智慧工厂--- 我们面向工业4.0的智能化发展 (CS17-VC1.6)	Yangqing Chen 陈阳清 ASM Assembly Systems Ltd. 先进装配系统有限公司
14:30 – 14:55	Pillarhouse Selective Soldering Phillarhouse 选择性波峰焊介绍 (CS17-VC1.7)	Penny Zhang 张帆 Pillarhouse Int'l 美国 Pillarhouse 公司
15:00 - 15:25	Advantages & Benefits of Nano Coating Stencils 纳米涂层钢网的优势与效益 (CS17-VC1.8)	Tyler Campos SIGMA Tin Alloy Co., Ltd. 星马焊锡有限公司

All papers will be presented in Chinese 所有演讲者都将使用中文



SMTA China South 华南高科技会议 Technology Conference

30th August 2017 (Wednesday) / 2017 年 8 月 30 日(星期三)

(CS17-VC2) Vendor Conference / 高科技设备研讨会		
Conference Chairman/会议主席: Yunhong Yu 余允红 Member of SMTA China Technical Committee / 中国 SMTA 技术委员会委员 Electronic Components & Products Applications Manager-Asia Pacific of Air Liquide (China) Holding Co., Ltd. 液化空气(中国)投资有限公司亚太电子应用技术经理		
Venue/地点	Booth 1R88, Hall 1., Shenzhen Convention & Exhibition Center, Shenzhen, China 中国深圳会展中心 1 号馆 1R88 展位	
Time/时间	Topic/议题	Speaker/主讲人
10:30 – 10:55	Smart #1 SMT Factory #1 SMT智慧工厂 --- 我们面向工业4.0的智能化发展 (CS17-VC2.1)	Yangqing Chen 陈阳清 ASM Assembly Systems Ltd. 先进装配系统有限公司
11:00 – 11:25	Gas Application Technology In PCBA --- Nitrogen Application On Inert Wave Soldering PCBA 中的气体应用技术 --- 波峰焊氮气技术 (CS17-VC2.2)	Yunhong Yu 余允红 Air Liquide (China) Holding Co., Ltd. 液化空气(中国)投资有限公司
11:30 – 11:55	Plasma Surface Treatment & Conformal Coating Applied In Automotive Electronics Industry 等离子表面处理及涂覆技术在汽车电子行业的应用 (CS17-VC2.3)	Johnson He 何华勇 Eric Gu 顾巍巍 Nordson Advanced Technologies 诺信高科技
12:00 – 12:25	2-Part Reactive Coating Solution 双组份涂覆解决方案 (CS17-VC2.4)	Scott Xu 徐东华 PVA 美国PVA公司
12:30 – 13:30	Lunch Break / 午餐	
13:30 – 13:55	Pillarhouse Selective Soldering Phillarhouse 选择性波峰焊介绍 (CS17-VC2.5)	Allan Jiang 姜霖 Pillarhouse Int'l 美国 Pillarhouse 公司
14:00 – 14:25	Rework Challenges for Leading Edge Components BGA, QFN and LED In Today's Fast Moving Industry 现今消费电子业对QFN、BGA、及LED的返修挑战 (CS17-VC2.6)	Paul Wood OK International 美国 OK 国际集团
14:30 – 14:55	Innovative Process Indicator for Oxidation of OSP PCB OSP PCB 氧化程度鉴定方法研究 (CS17-VC2.7)	Yu Xiang 项羽 Shenzhen City TongFang Electronic New-Material Co.,Ltd. 深圳市同方电子新材料有限公司
15:00 - 15:25	Gas Application Technology In PCBA --- Nitrogen Application On Cooling System PCBA 中的气体应用技术 --- 回流焊氮气冷量回收技术 (CS17-VC2.8)	Yunhong Yu 余允红 Air Liquide (China) Holding Co., Ltd. 液化空气(中国)投资有限公司

All papers will be presented in Chinese 所有演讲者都将使用中文

31th August 2017 (Thursday) / 2017 年 8 月 31 日(星期四)

(CS17-VC3) Vendor Conference / 高科技设备技术研讨会

Conference Chairman/会议主席:

Jojo Zhou 周全
Marketing Director of ZESTRON China / ZESTRON 中国市场总监

Venue/地点	Booth 1R88, Hall 1., Shenzhen Convention & Exhibition Center, Shenzhen, China 中国深圳会展中心 1 号馆 1R88 展位	
Time/时间	Topic/议题	Speaker/主讲人
10:30 – 10:55	Risk Mitigation In Hand Soldering 减轻手工焊接的风险 (CS17-VC3.1)	Paul Wood OK International 美国OK国际集团
11:00 – 11:25	Reliability Research of Low-Temperature Solder Paste 低温锡膏可靠性研究 (CS17-VC3.2)	Jiaqiang Huang 黄家强 Shenzhen City TongFang Electronic New-Material Co.,Ltd. 深圳市同方电子新材料有限公司
11:30 – 11:55	JBC Net Born for Industry 4.0 手工焊接工业 4.0 解决方案 (CS17-VC3.3)	Billy Shen 沈懿俊 JBC Soldering Tools (Shanghai) Trading Co., Ltd. 捷毕禧(上海)贸易有限公司
12:00 – 12:25	A Unique Approach to Board Test 独一无二的电路板测试策略 (CS17-VC3.4)	Yongrong Zhang 张勇荣 Checksum 美国查胜公司

All papers will be presented in Chinese 所有演讲者都将使用中文

邀请您免费参加高科技设备研讨会，集齐四个章可以参加现场抽奖活动，每天有大奖送出。

1. 大奖：红米 4A 手机 (玫瑰金色)
2. 普通奖：小米移动充电宝 或小米黑色商务背包 (奖品以实物为准)

集章参加现场抽奖规则明细：

1. 本抽奖活动由中国 SMTA 主办，参与抽奖人士仅限于 SMT 行业的专业观众，媒体和展商不能参加抽奖。
2. 每天集齐 4 个章可以参加抽奖活动，每天送出大奖 1 个。
3. 8 月 29 日和 8 月 30 日有 8 个时间段的演讲，8 月 31 日有 4 个时间段的演讲，每听完 1 个演讲，由现场工作人员盖 1 个章，当天盖章有效。
3. 于 8 月 25 日前通过邮件预登记设备研讨会的观众，事先送出 1 个章和小礼品 1 份(先到先得，发完即止)，请亲身前往深圳会展中心 1 号展馆 1R88 展位凭有效证件领取。
4. 凭有效证件领取奖品如：名片，工作证(厂牌)和身份证。
5. 此次活动最终解释权归主办方所有。